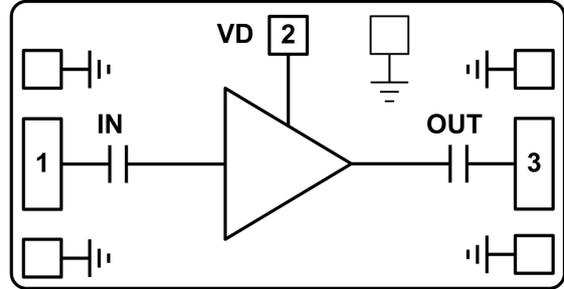




### 主要特点

- 工作频段: 0.5 – 4 GHz
- 增益: 18 dB
- 噪声系数: 1.8 dB
- 直流供电: 5 V/85 mA
- 反向隔离: 22 dB
- P1dB: +20 dBm
- 芯片尺寸: 1.25×1.2× 0.1 mm<sup>3</sup>

### 功能框图

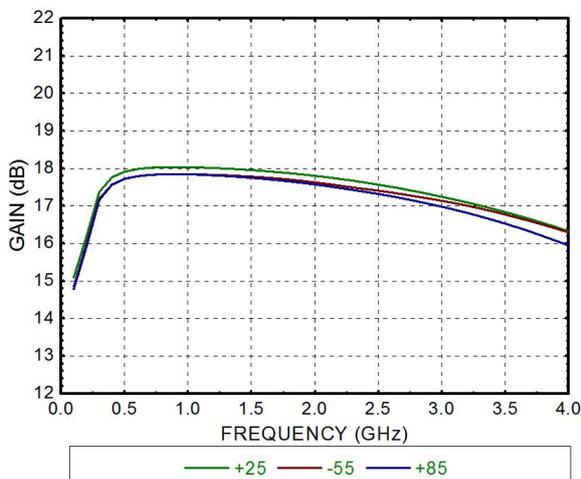


### 性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , 5V/85mA)

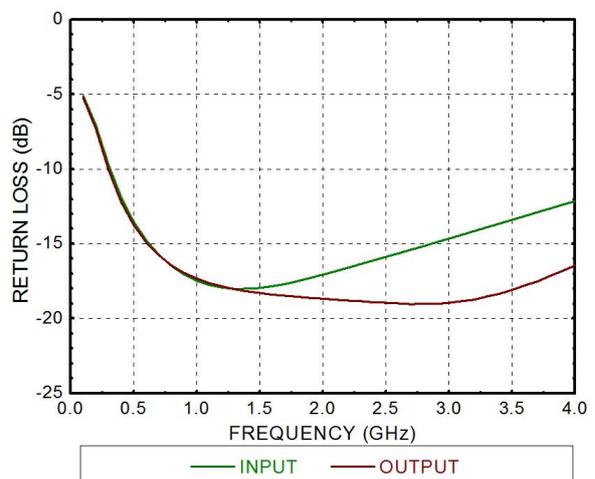
参数	最小	典型	最大	单位
工作频段	0.5 - 4			GHz
增益		18		dB
输入回波损耗		15		dB
输出回波损耗		15		dB
反向隔离度		22		dB
输出功率 1dB 压缩点		20		dBm
输出饱和功率		21		dBm
噪声系数		1.8		dB
输出 IP3		34		dBm
工作电流*	55	85	110	mA

\*若电流偏大, 可通过在电源端串联电阻来调节。例如, 当静态电流为 110mA 时, 通过串联 5 欧姆电阻则可以降至 80mA。

### 增益 vs. 温度

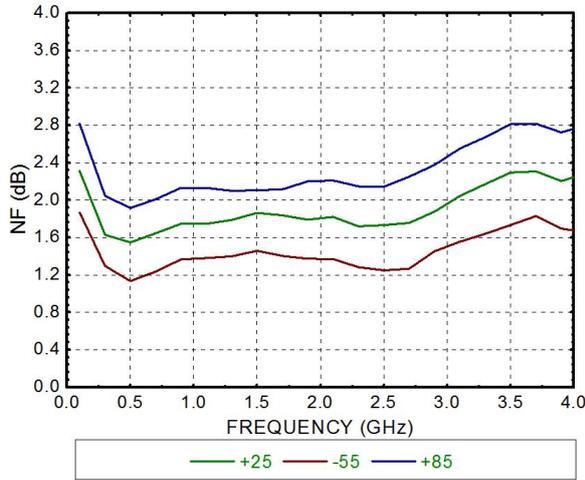


### 回波损耗

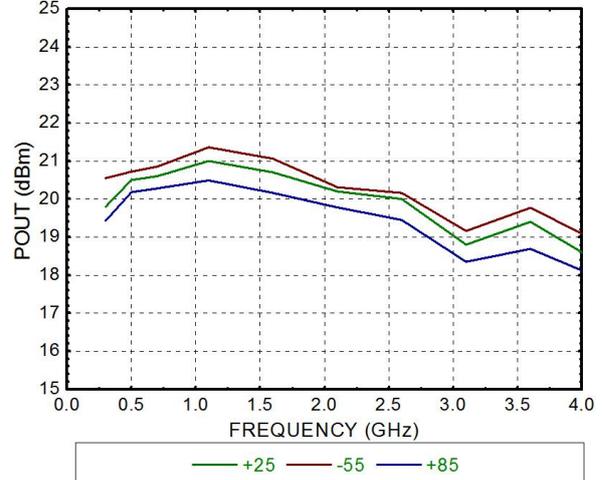




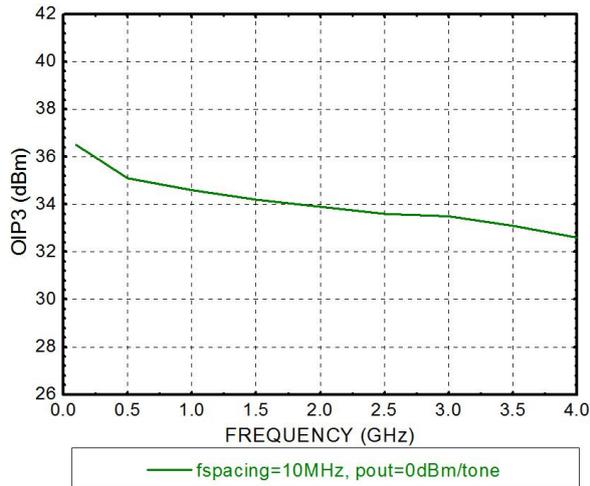
噪声 vs. 温度



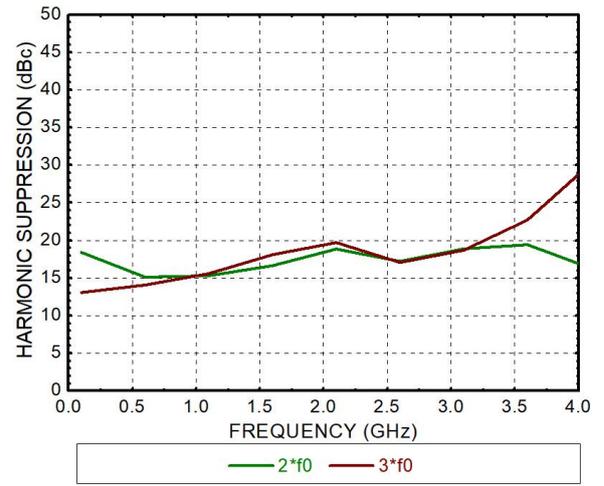
P1dB vs. 温度



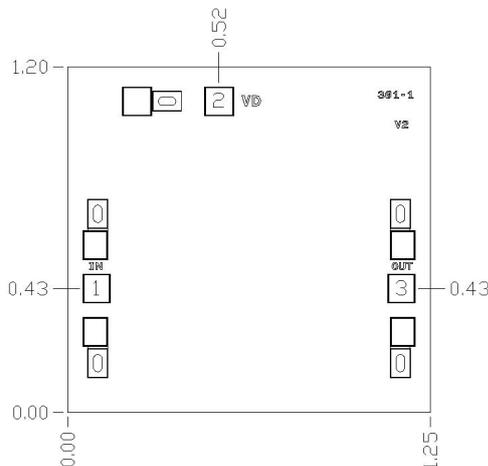
OIP3



谐波抑制 @ P1



物理参数



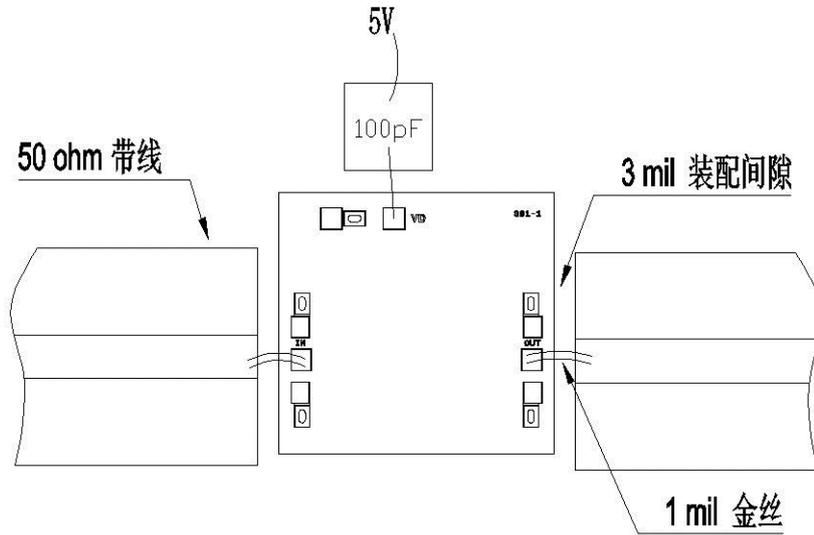
焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是 AC 耦合, 片上集成了隔直电容, 并匹配至 50 Ohm
2	VD	电源电压
3	OUT	该焊盘是 AC 耦合, 片上集成了隔直电容, 并匹配至 50 Ohm
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



## 1

### 装配图



### 极限参数

射频输入功率: +17dBm

储存温度: -65~+150°C

输出端口供电: +6V

工作温度: -55~+85°C